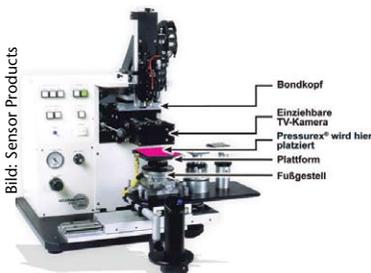


## Sensor Products

# Pressurex Druckmessfolie

Unbemerkte Pressdruckschwankungen können schlechte oder unterbrochene Flip-Chip Verbindungen ergeben, was zu Produktionsausfällen, einer geringeren langfristigen Betriebssicherheit sowie zu erhöhten Kosten führt. Die Einhaltung einer gleichmäßigen Pressdruckverteilung zwischen den Oberflächen eines Flip-Chip Werkzeugs stellt zum einen sicher, dass zwischen dem Basismaterial und dem Chip Planparallelität vorhanden ist und die Bondhügel optimal zusammengedrückt werden, und andererseits ein kontrollierter, reproduzierbarer Spalt zwischen Werkzeug und Basismaterial entsteht. Die Pressurex Druckmessfolie

ist ein wertvolles Hilfsmittel beim Einsatz eines Flip-Chart Bonders, der nicht in der Lage ist Druckschwankungen an der Oberfläche eines Bondwerkzeugs zu messen, sondern sich auf den durchschnittlichen Druck verlässt und wo einfach angenommen wird, dass ein einheitlicher Druck vorhanden ist. Wird Pressurex bereits erfolgreich beim Wafer-to-Wafer Bonden eingesetzt, so kann es in ähnlicher Weise beim Flip-Chip Bonden zum Einsatz kommen, um für eine preiswerte Überwachung der Planparallelität und Druckgleichmäßigkeit zu sorgen. Mit der Pressurex Druckmesssensorfolie ist eine komfortable, genaue, reproduzierbare und preiswerte Überwachung der Bondingphase wie auch der Planparallelität möglich. Die sehr dünne, flexible Sensorfolie zeigt Drücke zwischen 2 – 43.200 psi (0,14 – 3 000 kg/cm<sup>2</sup>). Plaziert man die Folie zwischen aufeinandertreffende Oberflächen eines Flip-Chip Bonders, so verändert sie ihre Farbe sofort und nachhaltig und zwar direkt proportional zum Ist-Druck. [www.sensorprod.com](http://www.sensorprod.com)



Pressurex zeigt ein Druckprofil auf der Oberfläche des Flip-Chip Bonders.